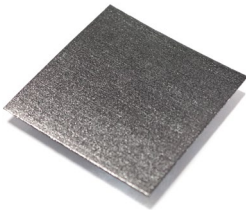


超高导热柔性石墨烯垫片

HGP系列是一种非常柔软的石墨烯加强TIM1 型取向垫片。具有超低热阻、低密度、易安装、可返工的优点。



特性和优点

- 低密度
- 高压缩
- 超高导热
- 低有效热阻

典型应用

- GPU, CPU封装内
- 光模块等高功率模组
- 高功率通讯基站芯片模组

典型属性		
属性	典型值	参考方法
颜色	灰黑色	目视
厚度(mm)①	0.3±10%	厚度规
密度(g/cc)	<0.95	ASTM D792
工作温度范围(°C)	-40 ~ 150	IEC 60068-2-14
压缩应力(psi @50%)	≤180	ASTM D575
回弹性(%)	≥60	ASTM D575
拉伸强度(MPa)②	≥0.03	ASTM D412
热阻(°C.cm ² /W @40psi)	≤0.06	ASTM D5470
标准片材(mm)	60*60	ASTM D5946
注：①厚度可定制化，范围 0.2-2.0mm		
②测试标准样条尺寸：15*40*0.3mm		
③可包边可点胶		

储存条件：

阴暗处储存

储存温度：≤30℃

储存湿度：≤70%

堆放高度不超过5层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：2 年